证券代码:603501　证券简称:豪威集团
转债代码:113616　转债简称:韦尔转债

豪威集成电路（集团）股份有限公司

2026 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	6,414,033,079.02	6,472,102,098.40	-0.90
利润总额	610,258,968.14	991,290,596.10	-38.44
归属于上市公司股东的净利润	502,949,305.92	865,970,220.63	-41.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	615,527,525.46	848,301,442.67	-27.44
经营活动产生的现金流量净额	737,078,999.39	1,097,915,586.75	-32.87
基本每股收益(元/股)	0.41	0.72	-43.06
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.72	-44.44
加权平均净资产收益率(%)	1.56	3.50	减少1.94个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	49,366,048,456.18	43,600,508,995.65	13.22
归属于上市公司股东的所有者权益	33,081,051,772.37	28,172,055,029.35	17.43

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,398,827.12	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	8,314,106.39	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-144,046,425.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,982,801.18	
减:所得税影响额	-22,639,323.33	
少数股东权益影响额(税后)	69,198.32	
合计	-112,578,219.54	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额	-38.44	注
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-27.44	
归属于上市公司股东的净利润	-41.92	
经营活动产生的现金流量净额	-32.87	
基本每股收益(元/股)	-43.06	
稀释每股收益(元/股)	-44.44	

注:

2026年第一季度,全球半导体产业在AI基础设施建设持续推动下,以存储芯片为代表的产品供需关系出现阶段性扰动,消费电子、汽车电子等终端市场需求承压,对公司当期营收规模形成一定影响。

受到上述因素的影响,2026年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为6.16亿元, 较去年同期减少约27.44%。半导体设计业务收入49.72亿元,占营业收入的77.52%,较上年同期减少8.56%;而半导体代理业务收入14.42亿元,占营业收入的22.48%,较上年同期增加39.40%。由于半导体代理业务收入占比提升,导致公司综合毛利率较上年同期减少了1.65个百分点。

2026年第一季度公司费用同比增长1.22亿元,主要体现为研发费用和财务费用的增加。其中,研发费用增加0.64亿元,主要是由于公司为积极布局新产品线进一步加大研发投入所致;与此同时,财务费用增加0.39亿元,则主要源于汇率波动而产生的汇兑损失所致。非经常性项目损失约1.13亿元,主要是公司持有的上市公司股权投资受股价波动影响,产生暂时性的公允价值变动损失所致。

此外,经营活动产生的现金流量净额同比减少3.61亿元,主要是由于购买商品、接受劳务支付的现金略有增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	198,004(其中A股股东197,991户,H股股东13户)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				不适用
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
虞仁荣	境内自然人	303,472,250	24.06	0	质押	171,790,000
香港中央结算有限公司	其他	105,323,063	8.35	0	无	0
绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	74,132,662	5.88	0	质押	15,856,000
宁波东方理工大学教育基金会	其他	71,200,100	5.65	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED(注)	境外法人	50,739,940	4.02	20,740,200	无	0
青岛融通民和投资中心(有限合伙)	其他	22,375,676	1.77	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	10,131,293	0.80	0	无	0
高盛国际-自有资金	境外法人	8,124,536	0.64	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	7,502,514	0.59	0	无	0
马剑秋	境内自然人	7,207,900	0.57	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
虞仁荣	303,472,250	人民币普通股	303,472,250
香港中央结算有限公司	105,323,063	人民币普通股	105,323,063
绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业(有限合伙)	74,132,662	人民币普通股	74,132,662
宁波东方理工大学教育基金会	71,200,100	人民币普通股	71,200,100
HKSCC NOMINEES LIMITED(注)	29,999,740	境外上市外资股	29,999,740
青岛融通民和投资中心(有限合伙)	22,375,676	人民币普通股	22,375,676
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	10,131,293	人民币普通股	10,131,293
高盛国际-自有资金	8,124,536	人民币普通股	8,124,536
中国工商银行股份有限公司-易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	7,502,514	人民币普通股	7,502,514
马剑秋	7,207,900	人民币普通股	7,207,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业(有限合伙)为虞仁荣先生控制的企业,虞小荣先生系虞仁荣先生弟弟,均为虞仁荣先生一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

注:HKSCC NOMINEES LIMITED为公司H股股东的集合账户,系中国香港登记机构根据当地市场惯例及其技术设置合并后向公司提供的原始数据,不代表最终持股人。公司H股IPO基石投资人共计认购20,740,200股H股,根据相关基石投资协议的约定,自上市日期(含当日)起六个月内,各基石投资人不得(且应促使其关联公司不得)以任何方式直接或间接出售其所认购的发售股份,或转让持有该等股份的任何公司或实体的权益,但少数例外情形(如转让给受相同禁售义务约束的全资附属公司)除外。受上述禁售安排影响,在前10名无限售条件股东持股情况中,HKSCC NOMINEES LIMITED的持有数量为29,999,740股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:豪威集成电路(集团)股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	16,387,128,383.35	12,820,808,745.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	470,403,001.98	125,672,949.95
衍生金融资产		
应收票据	4,887,654.58	118,051,125.21
应收账款	4,104,054,477.15	3,943,876,335.94
应收款项融资	185,282,155.83	219,184,600.13
预付款项	460,498,428.81	274,791,718.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	144,685,020.06	94,051,711.67
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,382,405,579.77	8,598,421,264.33
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,265,802.36	7,107,154.13
其他流动资产	202,306,443.59	264,585,436.00
流动资产合计	31,344,916,947.48	26,466,551,040.77
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	884,098,505.08	731,904,412.98
其他权益工具投资	4,072,955.13	4,072,955.13
其他非流动金融资产	3,965,281,284.09	3,656,012,172.91
投资性房地产	219,885,059.47	222,728,508.25
固定资产	3,404,844,525.35	3,442,032,997.38
在建工程	1,134,995,897.48	1,124,835,082.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	152,964,922.97	139,402,493.62
无形资产	2,091,526,370.84	1,995,511,856.56
其中:数据资源		
开发支出	1,532,551,023.24	1,400,985,470.98
其中:数据资源		
商誉	3,844,893,986.60	3,618,577,023.19
长期待摊费用	144,130,210.56	137,552,010.42
递延所得税资产	582,243,783.94	529,162,056.55
其他非流动资产	59,642,983.95	131,180,914.22
非流动资产合计	18,021,131,508.70	17,133,957,954.88
资产总计	49,366,048,456.18	43,600,508,995.65
流动负债:		
短期借款	2,198,492,890.61	2,078,985,512.66
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,943,317,170.32	2,234,501,984.64
预收款项		
合同负债	340,518,797.58	240,285,078.55
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	234,620,080.51	349,228,870.82
应交税费	394,287,213.43	342,964,171.34
其他应付款	1,169,340,197.26	1,331,045,097.82
其中:应付利息		
应付股利	5,046,470.00	5,046,470.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,516,826,424.85	6,004,932,453.27
其他流动负债	1,104,884.99	4,127,007.76
流动负债合计	13,798,507,659.55	12,586,070,176.86
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,239,390,471.08	1,617,721,215.79
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	112,711,340.22	95,285,668.89
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	491,128,649.85	472,803,347.70
递延收益	26,788,800.50	45,690,625.84
递延所得税负债	687,528,659.96	629,078,839.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,557,547,921.61	2,860,579,697.83
负债合计	16,356,055,581.16	15,446,649,874.69
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,261,074,075.00	1,209,759,889.00
其他权益工具	232,974,385.91	232,974,864.81
其中:优先股		
永续债		
资本公积	15,879,426,246.38	11,165,891,382.98
减:库存股	348,056,924.73	348,056,924.73
其他综合收益	60,175,344.16	418,976,477.56
专项储备		
盈余公积	328,318,602.61	328,318,602.61
一般风险准备		
未分配利润	15,667,140,043.04	15,164,190,737.12
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	33,081,051,772.37	28,172,055,029.35
少数股东权益	-71,058,897.35	-18,195,908.39
所有者权益(或股东权益)合计	33,009,992,875.02	28,153,859,120.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计	49,366,048,456.18	43,600,508,995.65

公司负责人:高文宝　主管会计工作负责人:徐兴　会计机构负责人:徐兴

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:豪威集成电路(集团)股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	6,414,033,079.02	6,472,102,098.40
其中:营业收入	6,414,033,079.02	6,472,102,098.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,614,317,844.58	5,423,699,548.71
其中:营业成本	4,529,549,423.76	4,463,732,975.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,620,896.66	7,763,362.06
销售费用	128,826,097.66	128,488,846.89
管理费用	193,791,393.56	175,793,584.29
研发费用	718,146,613.13	653,810,164.16
财务费用	33,383,419.81	-5,889,384.24
其中:利息费用	72,141,777.39	76,990,848.04
利息收入	123,122,597.74	89,989,318.58
加:其他收益	12,438,175.97	8,980,475.34
投资收益(损失以"-"号填列)	5,872,494.82	7,332,956.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,260,913.70	-7,998,985.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-147,658,006.12	-75,000.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-10,818,788.04	4,371,337.62
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-49,874,116.99	-77,475,510.32
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,398,827.12	-489,619.47
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	608,276,166.96	991,047,189.39
加:营业外收入	2,054,185.02	395,003.76
减:营业外支出	71,383.84	151,597.05
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	610,258,968.14	991,290,596.10
减:所得税费用	116,578,395.78	129,734,858.63
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	493,680,572.36	861,555,737.47
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	493,680,572.36	861,555,737.47
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	502,949,305.92	865,970,220.63
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-9,268,733.56	-4,414,483.16
六、其他综合收益的税后净额	-357,934,457.96	53,591,331.13
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-358,801,133.40	53,199,485.28
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		71,211,829.55
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		71,211,829.55
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-358,801,133.40	-18,012,344.27
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	233,178.40	
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-359,034,311.80	-18,012,344.27
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	866,675.44	391,845.85
七、综合收益总额	135,746,114.40	915,147,068.60
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	144,148,172.52	919,169,705.91
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-8,402,058.12	-4,022,637.31
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.41	0.72
(二)稀释每股收益(元/股)	0.40	0.72

公司负责人:高文宝　主管会计工作负责人:徐兴　会计机构负责人:徐兴

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:豪威集成电路(集团)股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,879,646,030.77	6,779,051,697.69
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	29,194,206.90	12,763,990.57
收到其他与经营活动有关的现金	191,846,085.98	128,204,464.44
经营活动现金流入小计	7,100,686,323.65	6,920,020,152.70
购买商品、接受劳务支付的现金	5,320,376,055.38	4,861,070,234.83
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	793,619,095.93	743,665,811.02
支付的各项税费	113,086,510.76	92,791,237.49
支付其他与经营活动有关的现金	136,525,662.18	124,577,282.61
经营活动现金流出小计	6,363,607,324.26	5,822,104,565.95
经营活动产生的现金流量净额	737,078,999.39	1,097,915,586.75
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	191,865,503.24	70,883,472.46
取得投资收益收到的现金	1,241,177.04	15,691,941.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	750,000.00	6,154,788.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	8,397,586.18	9,750,400.00
投资活动现金流入小计	202,254,266.46	102,480,602.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	487,980,520.82	543,983,183.31
投资支付的现金	1,145,478,078.81	258,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	67,392,209.70	
支付其他与投资活动有关的现金	325,023,229.81	
投资活动现金流出小计	2,025,874,039.14	801,983,183.31
投资活动产生的现金流量净额	-1,823,619,772.68	-699,502,580.70
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,723,165,658.44	65,979,297.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,206,622,965.72	848,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		7,019,222.38
筹资活动现金流入小计	5,929,788,624.16	920,998,520.31
偿还债务支付的现金	936,550,718.05	615,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,761,866.03	45,509,701.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		811,281.90
支付其他与筹资活动有关的现金	19,425,881.92	17,947,227.25
筹资活动现金流出小计	991,738,466.00	679,206,929.10
筹资活动产生的现金流量净额	4,938,050,158.16	241,791,591.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-276,234,507.26	-13,360,707.28
五、现金及现金等价物净增加额	3,575,274,877.61	626,843,889.98
加:期初现金及现金等价物余额	12,799,853,505.74	10,152,782,025.45
六、期末现金及现金等价物余额	16,375,128,383.35	10,779,625,915.43

公司负责人:高文宝　主管会计工作负责人:徐兴　会计机构负责人:徐兴

(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

豪威集成电路(集团)股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码:603501	证券简称:豪威集团	公告编号:2026-039
转债代码:113616	转债简称:韦尔转债	

豪威集成电路（集团）股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

豪威集成电路(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十五次会议于2026年4月29日以现场结合通讯方式召开,会议于2026年4月15日以通讯方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由公司董事长虞仁荣先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2026年第一季度报告》

《2026年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的经营情况和财务状况等事项,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《2026年第一季度报告》。

(二)审议通过《关于增资睿晶半导体有限公司暨关联交易的议案》

为进一步完善公司半导体产业链布局,通过与上游供应链环节的战略协同,打造更具韧性的供应链网络和交付保障体系,公司董事会同意以现金方式对睿晶半导体有限公司增资2亿元以持有其约2,560万元注册资本,公司本次交易构成与关联方共同投资的关联交易,增资完成后公司预计持有其注册资本占比约为5.13%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

关联董事吕大龙先生对该议案回避了表决。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《关于增资睿晶半导体有限公司暨关联交易的公告》(公告编号:2026-037)。

(三)审议通过《关于2026年"提质增效重回报"行动方案的议案》

为推动公司高质量发展和投资价值提升,提升核心竞争力,充分保障投资者尤其是中小投资者的合法权益,树立良好的资本市场形象,董事会同意公司制定2026年"提质增效重回报"行动方案。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《关于2026年"提质增效重回报"行动方案的公告》(公告编号:2026-038)。

特此公告。

豪威集成电路(集团)股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码:603501　证券简称:豪威集团　公告编号:2026-037
转债代码:113616　转债简称:韦尔转债

豪威集成电路（集团）股份有限公司关于增资睿晶半导体有限公司暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 投资标的及认购金额:豪威集成电路(集团)股份有限公司(以下简称"公司")拟以现金方式对睿晶半导体有限公司(以下简称"睿晶半导体"或"标的公司")增资人民币2亿元以持有其约2,560万元注册资本,以本轮增资规模人民币约10亿元计算,本次增资完成后公司预计持有其注册资本占比约为5.13%(以下简称"本次交易")。
- 本次交易构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 截至本公告披露日,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到3,000万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
- 本次交易已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,本次交易在公司董事会审议权限内,未达到股东会审议标准。
- 风险提示:

(一)公司正在与标的公司及本轮其他投资方就标的公司本次增资事项进行沟通,相关协议尚未正式签署,最终投资方案需经各投资方内部决策程序审批通过后方可生效,公司在本次交易后持有标的公司股权比例以最终签署的增资协议约定内容为准。

(二)本次投资旨在获取长期战略协同价值及未来潜在投资收益。但受宏观经济、行业周期、标的公司自身发展等多种因素影响,存在标的公司未来业绩波动、估值变化导致公司投资收益不及预期甚至出现投资损失的风险。

(三)半导体行业具有较强的周期性特征,受宏观经济、下游消费电子、汽车电子等终端需求变化影响。标的公司产品作为晶圆制造的核心原材料之一,其市场需求与下游晶圆厂代工新品开发节奏及产能利用情况呈正相关。若半导体行业进入下行周期,晶圆厂新品开发规模下降,标的公司将直接面临订单减少、产能闲置等局面,进而影响其经营业绩和现金流表现。

(四)标的公司所处的光掩膜版制造行业属于重资产投入行业,在未来的生产安排中,可能会出现由于折旧规模较大但高端工艺产品推进不如预期而出现较大亏损的情况。标的公司未来几年折旧费用与研发费用还将持续处于较高水平,亏损状态可能持续存在。标的公司估值可能因此出现变化导致公司投资收益不及预期甚至出现投资损失的风险。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本概况

1、本次交易概况

为进一步完善公司半导体产业链布局,通过与上游供应链环节的战略协同,打造更具韧性的供应链网络和交付保障体系,公司拟对睿晶半导体进行投资。除通过投资获取未来潜在投资收益外,通过投资睿晶半导体有利于公司锁定光掩膜版(Photomask)等关键产能,优化版图设计,缩短技术验证周期。公司现拟以现金方式对睿晶半导体增资人民币2亿元以持有其约2,560万元注册资本,以本轮增资规模约人民币10亿元计算,本次增资完成后公司预计持有其注册资本占比约为5.13%,具体以各投资人最终签署的协议约定为准。

鉴于公司董事吕大龙先生通过其控制的西藏智通创业投资有限公司(以下简称"西藏智通")持有睿晶半导体1,666.67万元注册资本,占标的公司本轮增资前4.49%股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司本次交易构成与关联方共同投资的关联交易。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 (增资现有公司((□同比例 (非同比例) --增资前标的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 (未持股公司 □投资新项目 □其他:______
投资标的名称	睿晶半导体有限公司
投资金额	(已确定,具体金额:人民币20,000万元 (尚未确定
出资方式	(现金 (自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他:______ □实物资产或无形资产 □股权 □其他:______
是否跨境	(是 (否

(二)已履行的审议程序

2026年4月29日,公司召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于增资睿晶半导体有限公司暨关联交易的议案》,关联董事吕大龙先生回避了本次表决。根据《公司章程》的相关规定,本次与关联方发生的交易在公司董事会审议权限范围内,无需提交至公司股东会审议。

(三)根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》,本次关联交易不构成重大资产重组,无需经过有关部门批准。

(四)截至本公告披露日,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到3,000万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方的基本情况

(一)西藏智通创业投资有限公司

1、关联方基本情况

名称	西藏智通创业投资有限公司
统一社会信用代码	91540195MA6T2XH89F
成立时间	2017年5月10日
注册地	西藏自治区拉萨市柳梧新区北京大道26号海亮天城9幢2单元9层2号
法定代表人	吕大龙
注册资本	3,000万元
主营业务	创业投资(不得从事担保和房地产业务;不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品);创业投资管理(不含公募基金。不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品;不得从事证券、期货类投资)(以上经营范围不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款;不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品;不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务。);商业管理;企业管理服务(不含投资管理和投资咨询);商业策划;房地产中介服务;房地产信息服务;广告设计、代理、发布。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东或实际控制人	北京银杏思远智通科技有限公司100%持有 (实际控制人吕大龙)

2、关联关系

公司董事吕大龙先生通过其控制的西藏智通持有睿晶半导体1,666.67万元注册资本,占标的公司本轮增资前4.49%股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司本次交易构成与关联方共同投资的关联交易。

三、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

睿晶半导体成立于2021年12月,主要从事中高端光掩膜版的研发、生产、销售及服务业务,目前该公司已实现对55纳米至180纳米等多个成熟制程节点的光掩膜版的研发、生产及销售,主要包括BIM,KrF PSM,ArF PSM,OMOG等种类掩膜版产品。睿晶半导体核心团队拥有20年以上行业龙头经验,具备丰富的研发量产经验和中高端制程技术实力。睿晶半导体依托团队技术路线搭建经验,采购符合业界技术标准的相关设备,其设备规格及技术能力能很好的满足头部晶圆厂的生产需求。目前睿晶半导体已覆盖的终端客户包括国内头部晶圆厂、集成电路制造企业及诸多芯片设计公司。凭借高性价比、快速响应及本地化服务优势,为国产芯片制造产业链的自主可控提供关键支撑。

(二)投资标的具体信息

1、投资标的基本情况

投资类型	(增资现有公司((同比例 (非同比例)
标的公司类型	未持股公司
全称	睿晶半导体有限公司
统一社会信用代码	(91330211MA2KPYPY5Q (不适用
法定代表人	祁耀亮
成立日期	2021年12月20日
注册资本	37,121.2122万元
实缴资本	32,666.6667万元
注册地址	浙江省宁波市镇海区九龙湖镇汶骆西路888号
主营业务	一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
所属行业	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业

2、主要股东情况

序号	股东名称	认缴出资(万元)	持股比例(%)
1	宁波募贤企业管理合伙企业(有限合伙)	4,900.00	13.20
2	宁波睿裔企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	4,511.00	12.15
3	青岛荣泽管理咨询合伙企业(有限合伙)	3,333.33	8.98
4	苏州元禾璞华智芯股权投资合伙企业(有限合伙)	3,333.33	8.98
5	北京酷讯科技有限公司	3,333.33	8.98
6	宁波甬欣韦豪三期半导体产业投资合伙企业(有限合伙)	2,866.67	7.72
7	平潭冯源玉柏股权投资合伙企业(有限合伙)	2,500.00	6.73
8	宁波市镇海威远镇芯一期半导体产业投资合伙企业(有限合伙)	1,969.70	5.31
9	宁波镇海集成电路产业园开发建设有限公司	1,666.67	4.49
10	宁波镇海瀚鋆股权投资合伙企业(有限合伙)	1,666.67	4.49
11	西藏智通创业投资有限公司	1,666.67	4.49
12	海南京安诚企业管理合伙企业(有限合伙)	1,666.67	4.49

3、睿晶半导体目前无实际控制人,在目前的股权结构下,睿晶半导体的日常运营与战略执行主要依托于高度专业化的核心管理团队。睿晶半导体核心团队由多位在半导体领域深耕二十余年的资深人士组成,核心成员曾任职于国内外大型半导体企业,并长期处于关键技术与管理岗位。团队成员在光掩模工艺研发、工厂生产管理与自动化、厂务基建等领域积累了丰富的实战经验,形成了覆盖产业链关键环节的专业合力。

4、投资标的最近两年数据

单位:人民币/万元

科目	2024年12月31日(经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	138,326.82	164,789.35
负债总额	48,522.31	92,497.81
所有者权益总额	89,804.51	72,291.53
资产负债率	35.08%	56.13%
科目	2024年度(经审计)	2025年度(经审计)
营业收入	4,056.73	17,052.45
净利润	-17,814.17	-9,313.75

注:标的公司2024年度及2025年度财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计;各分项数值之和与总数尾数不符的情况,为四舍五入原因所致。

(三)出资方式及相关情况

本次交易为公司现金自有资金出资,不会对公司日常资金周转造成不利影响,亦不存在对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响的情形。

四、本次交易的必要性和合理性

(一)保障关键原材料供应稳定,优化供应链布局

在全球半导体产业链博弈加剧、国产替代进程加速的行业背景下,光掩膜版作为芯片光刻环节的核心"母版",是连接芯片设计与晶圆制造的关键环节,其供应稳定性、技术适配性、交付效率直接决定芯片研发周期、良率、量产成本与市场竞争力。目前全球中高端光掩膜版市场主要由境外供应商主导。公司作为全球前十大芯片设计企业之一,保障供应链安全、缩短新产品迭代周期是可持续发展的需要。睿晶半导体已具备中高端光掩膜版的研发及量产能力,技术节点与公司的主力产品线高度匹配。通过资本纽带绑定,有助于公司构建更加多元稳定的原材料供应体系,保障公司研发及生产的连续性。

(二)优化产品全周期成本,提升公司研发及量产效率

光掩膜版成本是成熟制程芯片研发与量产的核心刚性开支之一,成熟制程芯片量产规模大、光掩膜版复用与迭代需求频繁,通过与光掩膜厂的战略合作,优化设计沟通、方案验证、缺陷修正等环节,在优化单片掩膜采购成本的同时,有利于缩短产品开发周期,降低公司产品研发及量产的时间成本与市场机会成本,实现产品全周期成本精准管控与效率提升。成熟制程光掩膜版市场需求基数大,芯片设计企业常面临旺季产能紧张、交付周期拉长、订单排期延误等问题,可能对芯片量产交付造成不利影响。通过对光掩膜版厂的财务投资,可锁定专属产能,保障成熟制程芯片稳定流片与规模化量产,提升公司对抗周期波动风险的能力。

五、本次交易的定价情况

本次交易定价在参考标的公司上一轮融资投后估值的基础上,充分考虑当前同行业可比公司的估值水平后,采用协商定价方式,经与标的公司现有股东及本轮其他投资人共同协商确定。

截至2025年12月31日,A股市场中主营业务与标的公司相近的上市公司市净率PB(MRQ)介于3.4倍至6.8倍的区间范围内。

本次交易中,睿晶半导体投前估值按29亿元人民币计算,对应其截至2025年末归属于母公司所有者权益的市净率约为4倍,接近前述A股可比公司的市净率区间的下限。目前同行业上市公司产品主要集中于130nm以上工艺节点的半导体芯片掩膜版,而睿晶半导体已实现55nm产品的制造能力且已实现国内头部晶圆厂批量供货,在工艺上具备一定优势。考虑到非上市股权与上市公司股权在股票流动性等方面客观上存在差异,通常会体现为一定的流动性折价。在综合考量流动性因素及企业个体发展差异后,本次交易的估值基本符合同行业上市公司的估值水平。

综上,本次关联交易定价合理、公允,遵循交易公平原则,并按照相关规定履行批准程序,不存在损害本公司利益及其他股东特别是中小股东利益的情形。

六、本次关联交易相关合同的主要内容

本次关联交易拟签订的《增资协议》核心条款如下所示,具体内容以各方最终签署的协议约定为准。

(一)合同主体

公司与睿晶半导体、睿晶半导体现有股东,睿晶半导体其他本轮投资人。

(二)交易价格

本轮投资人按照本次投前标的公司估值人民币29亿元进行本轮增资,标的公司本轮增资规模约为人民币10亿元。标的公司同意按照约定由本轮投资人认购总增资额相应增加注册资本。

(三)支付方式及期限

每一本轮投资人应按如下约定支付投资款:

1、自协议约定的先决条件被本轮投资人确认满足或书面豁免后的十(10)个工作日内,本轮投资人应以电汇方式向标的公司指定的银行账户汇出投资款。

2、为免疑义,对任一本轮投资人而言,其支付的投资款总额不应超过协议约定的相应的认缴出资金额。

3、尽管有上述约定,投资人应在协议约定的最晚支付日完成全部投资款的支付。

截至最晚支付日,如(i)任何先决条件未能实现或被相应本轮投资人豁免,则任何本轮投资人有权终止协议中与该本轮投资人有关的所有权利和义务;或(ii)任何本轮投资人未将全部投资款支付至目标公司指定银行账户的,则目标公司有权终止协议中与该本轮投资人有关的所有权利和义务,而不影响其他各方之间在本协议项下的权利和义务。目标公司与相应本轮投资人依上述规定终止相应权利义务的,各方应相互配合,就目标公司与相应本轮投资人之间就协议约定事项恢复至协议签署前的状态。

(四)增资变更登记及交割

1、自交割日起的六十(60)个工作日内,公司需就本次增资在市场监督管理局办理完成相应的变更登记手续、取得新的营业执照。各方应全力配合尽早完成本次增资的工商变更登记手续。

2、在交割日,目标公司应向本轮投资人提供如下文件:目标公司盖章确认与原件一致的、格式和内容合法合规、显示该本轮投资人为目标公司的股东并持有新增注册资本的章程、股东名册复印件。且目标公司应在任一本轮投资人支付投资款后向该本轮投资人出具相应的出资证明书复印件。

3、各方同意,对于每一本轮投资人而言,自交割日起相应本轮投资人即成为目标公司的股东,并按照交易文件的规定享有一切股东权利(包括该本轮投资人有权按其在目标公司的持股比例享有对目标公司以前全部年度及增资形成的全部所有者权益以及未分配的滚存利润)。

(五)违约责任

如果协议的一方("违约方")违反本协议或其作为合同方的其他交易文件,包括违反其在该等文件中所作的陈述和/或保证或未履行其在该等文件项下的任何义务或承诺,致使未违约的本协议或其他交易文件的当事方("受损方")蒙受任何损失,违约方应当就该等损失对受损方作出赔偿,并应当采取相应措施,使受损方免受任何进一步的损害。

对于本轮投资人遭受或产生的以下任何事项所导致或引起的损失,共同保证方应连带赔偿本轮投资人:

1、共同保证方严重违反了其任何共同保证;

2、任何共同保证方严重违反了本协议项下的任何承诺、约定或其它义务;或

3、任何共同保证方严重违反了其为一方的其它交易文件。

(六)生效及终止

1、协议自各方签署之日起生效。

2、协议在交割日前可因如下情形被终止:

(1) 经各方一致书面同意终止;

(2) 截至最晚支付日,如(i)任何先决条件未能实现或被相应本轮投资人豁免,则任何本轮投资人有权终止协议中与该本轮投资人有关的所有权利和义务;或(ii)任何本轮投资人未将全部投资款支付至目标公司指定银行账户的,则目标公司有权终止协议中与该本轮投资人有关的所有权利和义务,而不影响其他各方之间在本协议项下的权利和义务;

(3) 发生不可抗力事件且持续的时间超过一百八十(180)日,任何一方都可向其它各方发送书面通知终止协议;

(4) 如果一方严重违反协议的重要规定,而该违反无法被纠正或者没有在其他方发出书面通知后二十(20)个工作日内得到纠正,其他方有权书面通知终止本协议。

七、关联对外投资对上市公司的影响

本次交易是公司深化产业链协同战略的具体举措, 推动公司与上游关键供应商的合作关系从传统采购业务关系升级为战略合作关系。睿晶半导体是国内领先的中高端光掩膜版供应商,在光刻掩膜领域具备成熟的产品布局与稳定的供应能力。通过本次投资,公司与睿晶半导体在产品供应保障、技术验证加速、市场需求对接等方面建立深度联动机制。公司可以利用睿晶半导体的产能资源,巩固上游供应链基础,增强供应链韧性,有助于公司筑牢上游关键材料环节的供应链根基,提升产品竞争力,为公司长远战略发展提供了供应链支撑。

公司本次交易为财务投资,在财务报表上列为以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产。公司在保证日常经营所需资金的前提下,使用自有资金投资睿晶半导体,不会对公司日常经营活动及业绩产生重大不利影响。本次关联交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。本次交易完成不存在损害公司利益和侵害中小股东利益的行为,符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次交易亦不会形成同业竞争。

八、关联对外投资的风险提示

(一)公司正在与标的公司及本轮其他投资方就标的公司本次增资事项进行沟通,相关协议尚未正式签署,最终投资方案需经各投资方内部决策程序审批通过后方可生效,公司在本次交易后持有标的公司股权比例以最终签署的增资协议约定内容为准。

(二)本次投资旨在获取长期战略协同价值及未来潜在投资收益。但受宏观经济、行业周期、标的公司自身发展等多种因素影响,存在标的公司未来业绩波动、估值变化导致公司投资收益不及预期甚至出现投资损失的风险。

(三)半导体行业具有较强的周期性特征,受宏观经济、下游消费电子、汽车电子等终端需求变化影响。标的公司产品作为晶圆制造的核心原材料之一,其市场需求与下游晶圆厂代工新品开发节奏及产能利用情况呈正相关。若半导体行业进入下行周期,晶圆厂新品开发规模下降,标的公司将直接面临订单减少、产能闲置等局面,进而影响其经营业绩和现金流表现。

(四)标的公司所处的光掩膜版制造行业属于重资产投入行业,在未来的生产安排中,可能会出现由于折旧规模较大高端工艺产品推进不如预期而出现较大亏损的情况。标的公司未来几年折旧费用与研发费用还将持续处于较高水平,亏损状态可能持续存在。标的公司估值可能因此出现变化导致公司投资收益不及预期甚至出现投资损失的风险。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

九、关联对外投资履行的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

经独立董事认真审查,认为:本次关联交易符合公司经营发展和长期发展战略的需要;本次关联交易采用协商定价的方式,通过与标的公司现有股东及本轮其他投资人共同协商确定标的公司本轮的投前估值; 本次关联交易不会对公司本期及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响,且不存在损害公司和中小股东的利益的情形。同时,我们认为标的公司受半导体行业周期性影响,若下游需求放缓可能导致订单减少、业绩波动的风险。综上,我们同意将上述事项提交公司董事会审议。

(二)董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审核,认为本次关联交易遵循自愿、公开和公平的原则,符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东合法利益的情形,本次关联交易符合公司长远发展规划和全体股东的利益。同时,我们认为标的公司受半导体行业周期性影响,若下游需求放缓可能导致订单减少、业绩波动的风险。综上,我们同意将上述事项提交公司董事会审议。

(三)董事会审议情况

公司召开第七届董事会第十五次会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于增资睿晶半导体有限公司暨关联交易的议案》,关联董事吕大龙先生对该事项回避表决。本次关联交易在董事会审议权限内,无需提交至公司股东会审议。本次关联交易无需经过其他有关部门批准。

特此公告。

豪威集成电路(集团)股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码:603501	证券简称:豪威集团	公告编号:2026-041
转债代码:113616	转债简称:韦尔转债	

豪威集成电路（集团）股份有限公司2026年第二季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本公告所涉及的主要经营数据为初步核算数据,可能与公司2026年半年度报告中披露的数据存在差异,具体数据请以公司正式披露的2026年半年度报告为准。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

一、2026年第二季度主要经营数据

经财务部门初步估算,豪威集成电路(集团)股份有限公司(以下简称"公司")预计2026年第二季度实现营业收入71.50亿元至75.40亿元,较上年同期变动范围为-4.46%至0.75%,较上季度变动范围为11.47%到17.55%;公司毛利率约为28.70%至29.60%。

二、2026年第二季度经营情况

得益于汽车智能驾驶领域渗透加速,以及全景相机、运动相机等智能终端影像应用市场显著拓展,相关产品需求持续提升,为业务增长提供了有力支撑。与此同时,公司积极把握人工智能与实体经济融合带来的机遇,推动端侧AI、机器视觉等新兴应用场景落地,助力终端产品实现从"看到"向"看懂"的升级。在产品结构方面,公司持续推进技术成果转化,高端应用领域的产品序列不断丰富,管理效能同步优化,有效支撑了整体毛利率的稳定。公司将持续优化业务结构,积极开拓新兴下游应用场景,稳健拓展公司产品版图,同时强化供应链管理与成本管控,力争改善盈利能力,推动公司业务实现高质量发展。

三、风险提示

本公告所涉及的主要经营数据为初步核算数据,可能与公司2026年半年度报告中披露的数据存在差异,具体数据请以公司正式披露的2026年半年度报告为准。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

豪威集成电路(集团)股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码:603501	证券简称:豪威集团	公告编号:2026-042
转债代码:113616	转债简称:韦尔转债	

豪威集成电路（集团）股份有限公司关于"韦尔转债"回售的第二次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 回售价格:100.72元人民币/张(含当期应计利息、含税)
- 回售期:2026年5月8日至2026年5月14日
- 回售资金发放日:2026年5月19日
- 回售期内"韦尔转债"停止转股
- "韦尔转债"持有人可选择回售部分或全部未转股的可转换公司债券,本次回售不具有强制性。
- 风险提示:可转债持有人选择回售等同于以100.72元人民币/张(含当期利息、含税)卖出持有的"韦尔转债"。截至本公告披露日,"韦尔转债"的收盘价格高于本次回售价格,可转债持有人选择回售可能会带来损失,敬请可转债持有人注意风险。

豪威集成电路(集团)股份有限公司(以下简称"公司")的股票自2026年3月16日至2026年4月27日连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%,且"韦尔转债"已进入最后两个计息年度。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,"韦尔转债"的有条件回售条款生效,"韦尔转债"持有人有权将其持有的"韦尔转债"全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》,就回售有关事项向全体"韦尔转债"持有人公告如下:

一、回售条款及回售价格

(一)有条件回售条款

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权。可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

上述应计利息的计算公式为:$IA=B\times i\times t/365$

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。

(二)回售价格

根据上述当期应计利息的计算方法,"韦尔转债"第六年的票面利率2.00%,计算天数为131天(自2025年12月28日至2026年5月7日),利息为$100\times 2.00\%\times 131/365\approx 0.72$元/张,即回售价格为100.72元/张。(含当期应计利息、含税)。

二、本次可转债回售的有关事项

(一)回售事项的提示

"韦尔转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转债。"韦尔转债"持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。

(二)回售申报程序

本次回售的转债代码为"113616",转债简称为"韦尔转债"。行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内,通过上海证券交易所交易系统进行回售申报,方向为卖出,回售申报经确认后不能撤销。如果申报当日未能申报成功,可于次日继续申报(限申报期内)。

(三)回售申报期

2026年5月8日至2026年5月14日。

(四)回售价格

100.72元人民币/张(含当期应计利息、含税)。

(五)回售款项的支付方法

本公司将按前款规定的价格买回要求回售的"韦尔转债",按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则,回售资金的发放日为2026年5月19日。回售期满后,公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

三、回售期间的交易

"韦尔转债"在回售期间将继续交易,但停止转股。在同一交易日内,若"韦尔转债"持有人同时发出转债卖出指令和回售指令,系统将优先处理卖出指令。

回售期内,如回售导致可转债流通面值总额少于3,000万元人民币,可转债仍将继续交易,待回售期结束后,本公司将披露相关公告,在公告三个交易日后"韦尔转债"将停止交易。

四、风险提示

可转债持有人选择回售等同于以100.72元人民币/张(含当期利息、含税)卖出持有的"韦尔转债"。截至本公告披露日,"韦尔转债"的收盘价格高于本次回售价格,可转债持有人选择回售可能会带来损失,敬请可转债持有人注意风险。

五、联系方式

联系部门:公司证券部

联系电话:021-50805043

特此公告。

豪威集成电路(集团)股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码:603501	证券简称:豪威集团	公告编号:2026-040
转债代码:113616	转债简称:韦尔转债	

豪威集成电路（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会计政策变更是豪威集成电路(集团)股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部颁发的《企业会计准则解释第19号》的要求进行的变更,不会对公司可比期间财务数据产生影响,不会对公司损益、总资产、净资产等产生影响。

一、本次会计政策变更的概述

(一)变更依据

2025年12月5日,财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》(财会〔2025〕32号),规定了"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理"、"关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认"、"关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"、"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"等内容,该解释自2026年1月1日起施行。

本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的《企业会计准则解释第19号》的要求进行的变更,无需提交公司董事会和股东会审议。

(二)变更时间

公司根据财政部相关文件规定的起始日期执行上述新的会计政策。

(三)变更内容

1、变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

2、变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》的相关规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系根据财政部企业会计准则解释相关新规定进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,未损害公司和股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不会对公司可比期间财务数据产生影响,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

特此公告。

豪威集成电路(集团)股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码:603501	证券简称:豪威集团	公告编号:2026-038
转债代码:113616	转债简称:韦尔转债	

豪威集成电路（集团）股份有限公司关于2026年度"提质增效重回报"行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,推动公司高质量发展和投资价值提升,提升核心竞争力,充分保障投资者尤其是中小投资者的合法权益,树立良好的资本市场形象,公司结合自身发展战略及经营情况,豪威集成电路(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月29日召开了第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于2026年"提质增效重回报"行动方案的议案》。现将2026年"提质增效重回报"的行动方案主要措施公布如下:

一、聚焦主业经营,夯实高质量发展根基

(一)深耕主营业务,提升经营质效

公司是一家主要从事芯片设计业务的Fabless芯片设计公司,根据咨询机构TrendForce数据,公司是全球前十大无晶圆厂半导体公司之一,半导体设计业务聚焦图像传感器解决方案、显示解决方案、模拟解决方案三大核心板块。作为全球知名的提供先进数字成像解决方案的芯片设计公司,公司图像传感器解决方案市场份额位列全球第三,公司产品已广泛覆盖汽车、智能手机、家居安防、医疗、工业/机器视觉、新兴市场等领域。依靠公司在高端图像传感器产品的持续研发投入及高效的成果转化,公司聚焦主营业务,在诸多领域夯实市场领先地位,巩固并提升了公司的核心竞争力。

公司持续深化技术改革与先进技术成果转化,持续丰富公司在高端应用场景的产品序列,伴随在汽车智能驾驶领域渗透加速,以及在全景、运动相机等智能终端影像应用市场的显著扩张,相关领域的市场份额持续提升。2025年度,公司营业收入实现稳步增长,在营收规模持续扩张的同时,优化管理效能的持续优化,公司净利润与整体盈利能力同步得到有效释放与稳步提升,公司实现营业收入288.55亿元,较2024年增加12.14%。其中半导体设计业务产品销售收入实现238.00亿元,占主营业务收入的比例为82.60%,较上年增加9.98%;公司半导体代理销售业务实现收入49.05亿元,占公司主营业务收入的17.02%,较上年增加24.52%;公司归属于母公司股东的净利润为40.45亿元,较2024年增长21.73%。2025年公司半导体设计业务中,图像传感器解决方案业务实现营业收入212.46亿元,占主营业务收入的比例为73.73%,较上年增加10.71%,主要得益于公司面向汽车智能驾驶及新兴应用市场的图像传感器产品销售收入实现大幅增长。

公司所处的半导体行业是国家高新技术产业发展的关键环节,当前国内半导体企业正面临前所未有的机遇与挑战。为积极应对行业变化,公司持续强化在汽车电子及新兴市场CIS领域的竞争优势。在汽车图像传感器方面,公司推出了新一代采用TheiaCel?技术的800万像素CMOS图像传感器OX08D20。该产品是热门传感器OX08D10的升级版本,专为高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶(AD)中的汽车外部摄像头设计。除延续行业领先的暗态性能外,OX08D20还具备低功耗优势,并采用a-CSP?封装,其尺寸比同类外部传感器缩小50%。与此同时,公司的LCOS产品凭借特有的一体化驱动设计,实现了体积小、像素密度大、像素间距窄、功耗低以及显示效果优异等特点,已在智能眼镜(包括AR/XR/MR眼镜)、微型投影、汽车增强现实抬头显示(AR?HUD)以及全光通信传输网的波长选择开关(WSS)中实现量产供应。2025年,公司发布了业界首款面向新一代智能眼镜的超低功耗单芯片硅基液晶(LCOS)小面板——OP03021 LCOS面板。该产品采用0.26英寸光学尺寸,在90Hz场序输入下实现1632×1536的分辨率,能够助力新一代智能眼镜获得更高分辨率与更宽视场角(FoV)。这些特性正是消费者迫切需要的,可在智能眼镜日益普及的趋势下,带来更沉浸、更逼真、更舒适的增强现实(AR)体验。值得一提的是,OP03021全彩场序LCOS面板是目前市场上唯一一款将阵列、驱动器和存储器集成到超低功耗单芯片架构中的智能眼镜解决方案。

2026年,全球半导体产业受AI基础设施建设影响,细分领域供需关系出现扰动,消费终端市场承压明显。面对这一形势,公司将把握人工智能与实体经济深度融合的时代机遇,深化全球市场布局,强化"A+H"资本平台协同,积极开拓新兴下游应用场景,稳健开拓产品版图。同时,公司将持续深耕核心技术,加大新产品开发,进一步丰富产品矩阵,扩大半导体设计业务的产品类型与应用范围。此外,公司将结合行业特点与发展阶段,提前布局前沿技术,优化创新要素配置,提升研发与生产效率,并通过清晰的产品和市场定位构建稳定、高效的营销模式,形成差异化竞争优势。

(二)深化供应链整合,提升资产运营效率

公司与已有的晶圆厂、封装厂持续开展深度合作,同时在充分保障产品质量的前提下,持续优化公司的供应链布局,既有效保障了日益增长的产能需求,又进一步缩短了供应链响应周期、降低了综合制造成本。公司统筹各业务板块发展战略,充分发挥图像传感器、显示、模拟解决方案等业务体系在客户资源与供应链环节的协同效应,为客户提供整体的解决方案,持续提升整体生产效能与运营效率。

受益于上述供应链优化举措及产品结构升级的共同驱动,2025年度公司主营业务毛利率达30.59%, 较上年同期提升1.23个百分点。营业成本增幅低于营业收入增幅,主要得益于产品结构优化以及成本控制等因素,有效降低了单位产品制造成本。

2026年,公司将继续强化供应链管理体系建设,进一步优化存货结构,加快存货周转效率,降低资金占用水平。公司将通过精细化管理和技术升级,持续推进各环节的成本优化,不断提升资产运营效率和盈利质量。

(三)深化并购整合,提升规模效益

自上市以来,公司借助资本市场丰富的融资工具,通过并购重组实现了业务规模的重大突破,从原有的模拟业务扩充到了图像传感器及显示芯片业务,产品矩阵不断丰富,实现了各业务板块的高质量协同发展。

2026年,公司将持续关注市场潜在上下游并购机会,通过并购和投资进一步扩大公司的可触达市场,重点关注有益于公司产品组合的多样化及有益于扩大公司对邻近市场的覆盖的投资并购标的。凭借公司在通过收购扩大解决方案和业务规模方面的成功经验,公司将继续寻求和评估潜在的目标或战略合作,以便在技术、知识产权、产品和解决方案、供应链、客户群和长期增长机会方面创造强大的协同效应。

二、坚持创新驱动,加快发展新质生产力

作为采用Fabless业务模式的半导体设计销售业务公司,公司的持续研发能力是公司的核心竞争力。公司高度重视自主知识产权技术和产品的研发,以客户需求为导向不断创新研发机制,并持续稳定的加大在各产品领域的研发投入,加速研发成果转化,为产品升级及新产品的研发提供了充分的保障,使得公司产品竞争力稳步提升,研发投入的产出效益持续提高。

2025年,公司半导体设计业务研发投入金额约为36.80亿元,占公司半导体设计销售业务收入的15.46%,较上年增长13.38%;截至2025年末,公司共有研发人员人数为2,681名,其中硕士以上学历占比为61.06%;并拥有授权专利4,993项,其中发明专利4,787项,实用新型专利206项。另外,公司拥有布图设计136项,软件著作权86项。

公司持续突破关键技术瓶颈,不断提升高端图像传感器产品的成像性能与集成度,为多领域应用筑牢技术根基。紧抓汽车智能化发展机遇,公司以全球领先的市场份额优势,为高阶自动驾驶系统提供高安全性、高可靠性的视觉感知支撑;随着车联网、智能汽车、自动驾驶的普及,车载摄像头数量快速攀升,应用场景从传统倒车影像、行车记录仪向电子后视镜、360度全景成像、自动驾驶及驾驶员监控持续延伸,公司汽车市场相关收入保持快速增长,充分验证了公司在高端车载图像传感器领域的深厚技术积累与强劲竞争力。面向全球医疗健康需求升级,公司微型镜头模组解决方案凭借小型化、高精度的特点,可满足微创手术、手术机器人等场景的极致应用要求。同时,公司积极拥抱人工智能技术变革,加速推动端侧AI、机器视觉等新兴场景落地,持续为终端产品赋予智能化体验与核心竞争力。在智能手机领域,公司高端图像传感器产品凭借优异的性能表现,已广泛应用于国内主流高端智能手机后置主摄方案,市场份额稳步扩大,实现了高端智能手机领域的持续突破。

2026年,公司将充分利用在产品研发上的深厚经验及知识产权积累,持续加大在高端图像传感器、汽车电子、新兴市场等前沿领域的研发投入,进一步扩大竞争优势。公司将通过高效的技术开发、产品技术创新,不断丰富产品矩阵,持续为客户创造价值,构建产品研发的技术护城河,优化公司竞争格局,推进公司稳步高速持续增长。

三、健全治理体系,提升规范运作水平

(一)完善规章制度,提高治理水平

公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章以及《公司章程》的要求,结合公司当年发展情况,不断完善公司法人治理结构,规范公司运营运作。

2025年度,公司依据《上市公司章程指引》及实际情况,不再设置监事会及监事,原监事会职权由董事会审计委员会全面承接,并已完成《公司章程》及相关制度的配套修订。同时,公司持续深入落实独立董事制度履职保障机制,严格遵循《独立董事工作细则》,推动独立董事与公司管理层及外聘中介机构的定期沟通,充分发挥独立董事的专业性和独立性,在中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面发挥积极作用。

为贯彻落实国务院国资委及中国证监会关于上市公司市值管理工作的相关要求,公司已制定《市值管理制度》,明确市值管理目标、职责分工与资本运作路径,综合运用股份回购、现金分红、并购重组、股权激励等手段,持续提升公司投资价值与股东回报水平。公司高度重视舆情管理工作,已制定《舆情管理制度》,建立舆情监测、研判、应对及报告的全流程管理机制,有效防范和化解舆情风险,切实维护资本市场良好形象。

2026年,公司将持续优化治理架构与制度体系,根据《公司法》及监管政策最新要求,持续修订完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等内部治理制度,优化董事会各专门委员会运作机制,充分发挥审计委员会、战略与ESG委员会等的专业作用,提升公司决策的科学性与效率。

(二)深化ESG体系建设,推进可持续发展

公司秉持"赋能科技,感知无限"的使命宣言,"强协同为用户创新更大价值"的服务理念,在"持续技术创新多元杰出的人才高度协同的供应链与客户群"核心竞争力的依托下搭建公司可持续发展策略,并建立了由董事会、战略与ESG委员会及战略与ESG工作小组构成的三级ESG管治架构,明确其对应的ESG管治职能,实现自上而下的ESG事宜监管,保障公司ESG工作的顺利开展,实现经济责任与社会责任的共赢,进一步提升公司价值创造能力。

公司在ESG领域持续深耕,已根据相关要求连续6年编制《环境、社会及管治报告》,以透明和负责任的态度向公众展示公司在ESG领域的理念、战略、行动及成果。公司积极响应全球气候变化挑战,下属美国豪威已提交科学碳目标倡议(SBTi)承诺书,承诺短期、长期及净零温室气体减排目标,且该目标已于2025年1月通过了SBTi审验。同时,美国豪威已完成OV10652的产品碳足迹核算,通过精准识别产品生产全链路排放源,为产品端精细化减排管理奠定良好基础。此外,美国豪威亦积极响应CDP气候变化问卷,并取得B-评级,充分体现其在气候治理、碳排放管理等方面的良好成效。

公司在国际权威评级机构MSCI的ESG评级中获评BBB级,并在Wind ESG评级连续三年保持稳定在A级水平。

2026年,以H股上市为契机,公司将继续扎实推进ESG相关工作满足A+H两地监管合规要求,深化绿色运营举措,加大在节能减排、资源循环利用、绿色产品研发等领域的投入力度,积极应对气候变化挑战,严格落实环境合规管理要求,努力实现绿色运营与企业价值的协同增长,提升公司的长期可持续发展能力。

四、强化"关键少数"责任,筑牢规范运营防线

为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,公司已制定《高级管理人员薪酬绩效管理办法》《高级管理人员薪酬追回制度》,并于2026年3月6日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》,旨在进一步规范公司治理,引导董事及高级管理人员在履职过程中兼顾个人价值实现与企业社会责任,切实保障公司可持续发展。

2026年,公司将持续完善董高薪酬相关制度和方案,科学设定股权激励计划的业绩考核指标。加强公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束,强化"关键少数"人员合规意识,推动管理层与股东利益深度绑定,切实推动公司高质量发展。公司将组织相关人员积极参加证券交易所、属地证监局、上市公司协会等举办的培训,持续学习最新法律法规,掌握证券市场相关规则,不断强化自律和合规意识,推动公司持续规范运作。

五、强化股东回报举措,现金分红与回购并举

(一)持续推进一年多次现金分红,构建稳定回报

公司高度重视对投资者的合理投资回报,在保证主营业务发展合理需求的前提下,结合实际经营情况和发展规划,公司遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策,为投资者带来长期、稳定的投资回报,增强广大投资者的获得感。同时,为完善公司利润分配政策,增强利润分配的透明度,保护公众投资者的合法权益,公司已根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定,制定了《豪威集成电路(集团)股份有限公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划》,保证股东的合理投资回报,增加股利分配决策的透明度和可操作性。

2025年度,公司分别实施了2024年年度利润分配方案和2025年中期利润分配方案,共计派发现金红利746,652,847.24元。2025年4月16日,公司发布了2024年度利润分配的方案,并于2025年8月1日完成了此次利润分配,共计派发现金红利264,459,672.84元。2025年10月29日,公司发布了2025年度中期利润分配的方案,并于2025年11月24日完成了此次利润分配,共计派发现金红利482,193,174.40元。

2026年,公司将在正常持续经营的前提下,根据所处发展阶段,结合经营现状、业务发展规划及营运资金投入情况,继续推行一年多次现金分红的股东回报模式。公司将严格执行《未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划》,在保证主营业务发展合理需求的同时,为投资者提供连续、稳定的现金分红,持续提升股东回报水平,落实打造"长期、稳定、可持续"的股东价值回报机制。

(二)持续落实回购方案,推进回购股份注销

自公司上市以来,公司持续以自有资金通过集中竞价交易方式开展股份回购,积极提振市场信心,共推出5次股份回购方案,已实施完成的方案累计回购金额约为19.35亿元。

2025年4月15日,公司召开第六届董事会第四十三次会议审议通过了《关于变更2024年回购股份用途并注销的议案》,将2024年度回购的11,213,200股股份用途变更为"用于注销并减少注册资本"。公司本次注销的回购股份对应回购金额约10亿元,并已于2025年8月完成注销手续,公司总股本相应减少11,213,200股,有利于增厚每股收益,切实提高股东投资回报,增强投资者对公司的投资信心。

2026年,公司计划以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分股份,回购金额不低于8亿元、不高于10亿元,回购价格不高于100元/股,回购股份拟全部用于后续实施员工持股计划或股权激励,以进一步完善长效激励机制,充分调动核心人员积极性。同时,公司计划将2023年回购股份方案中已回购但尚未使用的3,921,163股库存股用途变更为"用于注销并减少注册资本",并相应办理注销手续。此外,公司将根据市场情况和经营发展需要,适时评估并推进股份回购计划的实施,在符合条件的情况下研究推进回购股份注销,持续提振市场信心,增厚股东权益。

六、加强投资者沟通,传递公司长期价值

(一)提高信息披露水平,增强信息可读性

公司高度重视投资者关系管理工作,严格遵守法律法规和监管机构规定,严格执行公司信息披露管理制度,坚持以投资者需求为导向,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务,优化信息披露工作,努力提高信息披露质量和透明度,并常态化通过长图文、视频、公司官方公众号等形式对公司业务及定期报告进行解读,提高公告的可读性、直观性,将公司营运情况、财务状况结合,全面、全方位地呈现在投资者面前。公司同时持续编制和披露ESG报告,展现公司在可持续发展方面的实践与成果,增进投资者对公司长期价值的认识。

(二)拓宽投资者沟通渠道,传递公司投资价值

公司高度重视投资者关系管理,持续不断完善投资者关系管理相关制度,积极建立与资本市场的有效沟通机制,全面保障投资者,尤其是中小投资者的知情权及其他合法权益。同时,公司建立了多元化投资者沟通交流渠道,并已设立专职人员负责投资者关系,积极通过常态化召开业绩说明会(每年召开不少于3次)、上证e互动、股东会、投资者交流会、调研、投资者热线/邮箱等多样化渠道开展投资者关系管理工作,回应投资者关切,及时、准确的向投资者传递公司经营发展信息,加强与投资者的沟通与互动,传递公司投资价值,促进公司与投资者之间建立长期、稳定、信赖的关系。

2026年,公司将继续遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则,多层次、多角度、全方位地展示公司经营等方面的进展,让投资者全面及时地了解公司的发展战略、商业模式、经营状况。公司将安排专人及时接听投资者热线、回复投资者邮箱及"上证e互动"平台咨询,确保投资者日常关切得到及时回应。公司将常态化召开业绩说明会,每年不少于3次,并邀请高管团队共同参与。在年度报告及半年度报告发布后,公司将分别推出1期长图文解读材料,以直观、生动的方式阐释业绩亮点与发展趋势,提升信息披露的可读性与透明度。公司将在合规前提下丰富沟通方式,邀请董事、管理层及业务负责人参与投资者关系活动,积极传递公司长期投资价值,增强市场对公司的认可度与信任度。

公司将持续评估本次"提质增效重回报"行动方案的具体举措进展情况,始终贯彻聚焦主营业务,提升经营质量,并以良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的股东回报,回馈投资者的信任,切实履行上市公司的责任和义务,积极传递公司价值,维护公司市场形象,共同促进资本市场平稳运行。本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

豪威集成电路(集团)股份有限公司董事会
2026年4月30日